

北京君正集成电路股份有限公司

2026 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形

（1）以区间数进行业绩预告的

单位：万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	107,861.44	~	128,235.26		20,311.63
	比上年同期 增长	431.03%	~	531.34%	
扣除非经常性损益后的净利润	104,911.32	~	125,285.14		16,091.4
	比上年同期 增长	551.97%	~	678.58%	

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，但公司就业绩预告有关重大事项与其进行了沟通，公司与审计机构在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，受益于存储大周期的推动，公司存储芯片需求旺盛，其中公司 DRAM 产品由于供应持续紧张，产品售价涨幅较大，公司 Flash 产品受益于 AI 服务器、光模块等领

域的发展，销量同比明显增长，公司存储芯片销售收入总体实现了较大幅度的增长；同时，受原材料 KGD 缺货、涨价等因素影响，公司计算芯片产品进行了价格上调，销售收入同比实现强劲增长。

受上述等因素影响，报告期内公司总体营业收入同比实现了较好的增长，2026 年半年度公司实现营业总收入约为 398,877 万元，同比增长约 77%；同时，公司毛利率持续增长，2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期实现大幅增长。

本报告期非经常性损益约为 2,950 万元，去年同期为 4,220 万元。

四、其他相关说明

本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 13 日